PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-265662

(43) Date of publication of application: 07.10.1997

(51)Int.Cl.

G11B 7/24

G11B 7/00

(21)Application number: 08-097565

(71)Applicant: SONY DISC TECHNOL:KK

(22)Date of filing:

27.03.1996

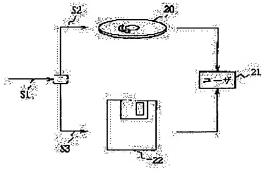
(72)Inventor: FURUYAMA KAZUO

(54) DISCOID RECORDING MEDIUM AND ITS MANUFACTURE AND METHOD FOR SUPPLYING INFORMATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently and effectively protect an optical disk against unauthorized duplication by forming a disk substrate with a rugged pattern based on a 2nd recording signal obtained by modulating a 1st recording signal.

SOLUTION: This method for supplying information is performed in such a manner that the 1st recording signal S1 to be recorded on the optical disk 20 is modulated by making its prescribed partial part the blank state into the 2nd recording signal S2, and this signal S2 is recorded as a rugged pattern on the substrate of the optical disk 20 to be supplied to the user. On the other hand, the prescribed partial part (a 3rd recording signal) of the 1st recording signal S1 is recorded on a floppy disk 22 to be supplied to the user. On the side of the user 21, the 1st recording signal S1 is reproduced based on the 2nd recording signal S2 obtained from the optical disk 20 and the 3rd recording signal S3 obtained from the floppy disk 22. Consequently, even when the optical disk 20 is



duplicated, the whole part of the 1st signal S1 cannot be obtained so that the protection against unauthorized duplication can efficiently and effectively be performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-265662

(43)公開日 平成9年(1997)10月7日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G11B	7/24	5 2 2	8721-5D	G11B	7/24	5 2 2 Z	
	7/00		9464-5D	•	7/00	K	

		審査請求	未請求 請求項の数5 FD (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平8-97565	(71) 出願人	594064529 株式会社ソニー・ディスクテクノロジー
(22)出願日	平成8年(1996)3月27日		神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
		(72) 発明者	古山 和雄 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 株式会社ソニー・ディスクテクノロジー内
		(74)代理人	弁理士 田辺 恵基

(54) 【発明の名称】 デイスク状記録媒体及びその製造方法並びに情報供給方法

(57)【要約】

【課題】違法複製を効率良くかつ効果的に防御し得るデ イスク状記録媒体及びその製造方法並びに情報供給方法 を実現し難かつた。

【解決手段】第1の記録信号を所定の一部がブランク状 態となるように変調してなる第2の記録信号に基づいて デイスク基板の一面に凹凸パターンを形成するようにし たことにより、違法複製を効率良くかつ効果的に防御し 得るデイスク状記録媒体及びその製造方法を実現でき る。また第1の記録信号を所定の一部がブランク状態と なるように変調してなる第2の記録信号が記録された光 デイスクを作製してユーザに供給すると共に、第1の記 録信号の所定の一部を所定の情報供給手段を介してユー・ ザに供給するようにしたことにより、違法複製を効率良 くかつ効果的に防御し得る情報供給方法を実現できる。

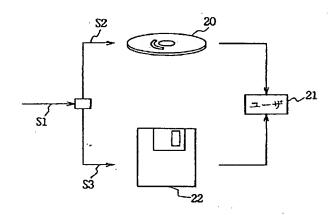


図1 第1 実施例による情報供給方法

10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の記録信号を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号に基づいて一面に凹凸パターンが形成された、光透過性物質からなるデイスク基板と、

上記デイスク基板の上記一面上に積層形成された、高反射物質からなる反射膜層と、

上記反射膜層上に積層形成された所定材料からなる保護 膜層とを具えることを特徴とするデイスク状記録媒体。

【請求項2】上記反射膜層は、

上記第2の記録信号に代えて上記第1の記録信号に基づいて上記デイスク基板の上記一面に凹凸パターンを形成したときに、当該第1の記録信号の上記所定の一部に基づいてピツトが形成される上記デイスク基板の上記一面の各部位にそれぞれ対向させて、それぞれ対応する上記ピツトと同じ開口寸法で形成された複数の貫通孔を具えることを特徴とする請求項1に記載のデイスク状記録媒体。

【請求項3】第1の記録信号を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号に基づいて 20一面に凹凸パターンが形成されたデイスク基板を形成する第1の工程と、

上記デイスク基板の上記一面上に高反射物質からなる反射膜層を形成する第2の工程とを具えることを特徴とするデイスク状記録媒体の製造方法。

【請求項4】上記第2の記録信号に代えて上記第1の記録信号に基づいて上記デイスク基板の上記一面に凹凸パターンを形成したときに、当該第1の記録信号の上記所定の一部に基づいてピツトが形成される上記デイスク基板の上記一面の各部位にそれぞれ対向させて、それぞれ 30対応する上記ピツトと同じ開口寸法で上記反射膜層に貫通孔を形成する第3の工程を具えることを特徴とする請求項3に記載のデイスク状記録媒体の製造方法。

【請求項5】第1の記録信号を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号が記録された光デイスクを作製してユーザに供給すると共に、上記第1の記録信号の上記所定の一部を所定の情報供給手段を介して上記ユーザに供給することを特徴とする情報供給方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【目次】以下の順序で本発明を説明する。

発明の属する技術分野

従来の技術(図8及び図9)

発明が解決しようとする課題(図8及び図9)

課題を解決するための手段(図1~図7)

発明の実施の形態

- (1) 第1 実施例(図1~図4)
- (2) 第2 実施例(図2、図5~図7)
- (3)他の実施例(図1~図7)

発明の効果

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明はデイスク状記録媒体 及びその製造方法並びに情報供給方法に関し、特に光デ イスク及び光デイスクを用いた情報供給に適用して好適 なものである。

[0003]

【従来の技術】従来、例えば光デイスクにおいては、図8(A)~図9(C)に示す以下の手順により製造されている。すなわち、まず一面1Aが極めて平滑に形成されたガラス又はニツケルからなる基板1の当該一面1A上にフオトレジストを塗布することによりレジスト層2を形成する(図8(A))。

【0004】次いでこのレジスト層2を記録信号に応じ

て露光し(図8(B))、現像することにより、基板1の一面1A上に、残存するレジスト層2によつて記録信号に応じた凹凸パターンを形成する(図8(C))。なお以下においては、このように基板1の一面1A上にレジスト層2からなる記録信号に応じた凹凸パターンが形成されたものをレジスト・マスタ3と呼ぶものとする。【0005】続いてこのレジスト・マスタ3の凹凸パターン上に無電解めつき法により導電化膜層4を形成し(図8(D))、この後当該導電化膜層4上に電解めつき法により電鋳層5を形成する(図8(E))。さらにこの導電化膜層4及び電鋳層5を一体に基板1から剥離し、洗浄した後、中心部に開口(センターホール)6Aを形成することによりスタンパ6を作成する(図8

【0006】次いでこのスタンパ6を用いて射出成形法により光透過性物質からなるデイスク基板7を成形し(図9(A))、この後このデイスク基板7の凹凸面7A上にスパツタリング等によりアルミニウムなどの高反射物質からなる反射膜層8を積層形成する(図9(B))。

【0007】続いてこの反射膜層8上にスピンコート法等により紫外線硬化樹脂材を所定厚で塗布すると共に、この後これを硬化させることにより保護膜層9を形成する(図9(C))。これによりデイスク基板7の凹凸面7Aでなる信号記録面に記録信号に応じた凹凸パターン40を有する光デイスク10を得ることができる。

[0008]

(F)),

【発明が解決しようとする課題】ところでこのようにして製造される光デイスク10においては、通常、違法複製に対するプロテクト手段として、IFPI(International Federation Of The Phonographic Industry)で推奨しているSID(Source Identification)コードを予めマスタリング工程時にスタンパ6に記録しておく方法が用いられている。

【0009】しかしながらこのような方法を用いたとし 50 ても、例えば光デイスク10の反射膜層8及び保護膜層

20

9をデイスク基板7から剥離し、当該デイスク基板7の 凹凸面7Aに形成された凹凸パターンに基づいて光デイ スク10を複製する方法に対しては防御できない問題が あつた。

【0010】本発明は以上の点を考慮してなされたもの で、違法複製を効率良くかつ効果的に防御し得るデイス ク状記録媒体及びその製造方法並びに情報供給方法を提 案しようとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた 10 め第1の発明においては、デイスク状記録媒体におい て、第1の記録信号を所定の一部がブランク状態となる ように変調してなる第2の記録信号に基づいて一面に凹 凸パターンが形成された、光透過性物質からなるデイス ク基板を設けるようにした。

【0012】また第2の発明においては、デイスク状記 録媒体の製造方法において、第1の記録信号を所定の一 部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録 信号に基づいて一面に凹凸パターンが形成されたデイス ク基板を形成する第1の工程を設けるようにした。

【0013】さらに第3の発明においては、情報供給方 法において、第1の記録信号を所定の一部がプランク状 態となるように変調してなる第2の記録信号が記録され た光デイスクを作製してユーザに供給すると共に、第1 の記録信号の所定の一部を所定の情報供給手段を介して ユーザに供給するようにした。

【0014】この結果第1及び第2の発明では、デイス ク基板の複製だけでは第1の記録信号の全部を得ること ができないようにすることができる。また第3の発明で も、光デイスクの複製だけでは第1の記録信号の全部を 30 得ることができないようにすることができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下図面について、本発明の一実 施例を詳述する。

【0016】(1)第1実施例

図1は、第1実施例の概要を示すものであり、光デイス クに記録しようとする第1の記録信号S1を所定の一部 (例えばTOC (Table Of Contents)) がブランク状 態となるように変調することにより第2の記録信号S2 を形成し、当該第2の記録信号S2を光デイスク20に 40 記録してユーザ21に供給する一方、これとは別に上述 の第1の記録信号S1の所定の一部(以下、これを第3 の記録信号 S 3 と呼ぶ)を例えばフロツピイデイスク 2 2等に記録してユーザ21に供給するようにし、ユーザ 21側においてこれら光デイスク20から得られる第2 の記録信号S2と、フロツピイデイスク等22から得ら れる第3の記録信号S3とに基づいて第1の記録信号S 1を再生するようにする。

【0017】ここで、実際上このような光デイスク20 は、図2に示す光デイスク製造手順RT1に従つて図3 50

(A) ~図4 (C) のようにして作製することができ る。すなわち、まず従来と同様にして、図3(A)のよ うに一面が極めて平滑に形成された基板30の一面30 A上にフオトレジストを塗布することによりレジスト層

31を形成する(ステツプSP1)。

【0018】続いて図3(B)に示すように、このレジ スト層31を記録信号に応じて露光する (ステツプSP 2) 。この際フォーマツタを改造しておくことにより、 記録すべき第1の記録信号S1(図1)を所定の一部が ブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号 S2がフオーマツタからカツテイングマシンに供給され るようにし、かくして当該カツテイングマシンによりレ ジスト層31に無変調部分のある溝をカツテイングさせ る。

【0019】次いでこのレジスト層31を現像すること により、図3 (C) に示すように、基板30の一面30 A上に記録信号に応じた無変調部分を有する凹凸パター ンを形成し、この後かくして形成されたレジストマスタ 32の凹凸パターン上に無電解メツキ及び電解メツキを 順次施すことにより、図3(D)に示すように、ニツケ ル等からなる導電化膜層33及び電鋳層34を順次積層 形成する(ステツプSP3)。

【0020】続いて図3(E)に示すように、この導電 化膜層33及び電鋳層34をレジストマスタ32から一 体に剥離し、洗浄した後、図3(F)に示すように、セ ンターホール40Aを形成することによりスタンパ40 を作成する。さらにこの後図4(A)に示すように、こ のスタンパ40を用いて射出成形法によりボリカーボネ イト等の光透過性物質からなるデイスク基板41を成形 し (ステツプSP4) 、この後このデイスク基板41の 凹凸面41A上にスパツタリング等によりアルミニウム などの高反射物質からなる反射膜層42を積層形成する (ステツプSP5)。

【0021】続いてこの反射膜層42上にスピンコート 法等により紫外線硬化樹脂材を所定厚で塗布すると共 に、この後これを硬化させることにより保護膜層43を 形成し(ステツプSP6)、さらにこの後この保護膜層 43の表面43A上にラベル等を印刷する(ステツプS P7)。これにより第1の記録信号S1を所定の一部が ブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号 S2が記録された光デイスク20を得ることができる (ステツプSP8)。

【0022】以上の構成において、この第1実施例で は、第1の記録信号S1を所定の一部がブランク状態と なるように変調してなる第2の記録信号S2が記録され た光デイスク20を作製してこれをユーザ21に供給す る一方、これとは別に上述の第1の記録信号S1の所定 の一部でなる第3の記録信号S3を例えばフロツピイデ イスク22等に記録してユーザ21に供給する。従つて この方法によれば、例えば光デイスク20から反射膜層

成する。

42 (図4 (C)) 及び保護膜層43 (図4 (C)) を 剥離し、かくして得られたデイスク基板41 (図4

(C)) に基づいて光デイスク20が違法複製された場合においても当該複製された光デイスク20だけでは第1の記録信号S1全部を得ることができず、その分光デイスク20の違法複製を効果的かつ確実に防御することができる。

【0023】なおこの方法は、特にCD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)のように記録情報の一部が欠落した場合に当該記録情報の再生が困難なフオーマ 10ットで情報が記録された光デイスクや、今後新規の形態で発売される光デイスクに対して有効である。

【0024】以上の構成によれば、第1の記録信号S1を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2記録信号S2が記録された光デイスク20を作製してこれをユーザ21に供給する一方、これとは別に上述の第1の記録信号S1の所定の一部でなる第3の記録信号S3を例えばフロツピイデイスク22等に記録してユーザ21に供給するようにしたことにより、光デイスク20が複製されても第1の記録信号S1の全部を得るこ20とができないようにすることができ、かくて違法複製を効率良くかつ効果的に防御し得る光デイスク及びその製造方法並びに情報供給方法を実現できる。

【0025】(2)第2実施例

図5は第2実施例による光デイスク50を示すものであり、ポリカーボネイト等の光透過性物質からなるデイスク基板51の凹凸面51A上にアルミニウム等の高反射物質からなる反射膜層52が積層形成されると共に、当該反射膜層52上にUV硬化樹脂等からなる保護膜層53が積層形成され、当該保護膜層53上にラベルが印刷 30されることにより形成されている。

【0026】この場合デイスク基板51の凹凸面51Aには、第1実施例のデイスク基板41と同様に、第1の記録信号S1(図1)を所定の一部(例えばTOC)がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号S2が凹凸パターンとして記録されている。また反射膜層52には、第2の記録信号S2に代えて第1の記録信号S1に基づいてデイスク基板51の凹凸面51Aに凹凸パターンを形成したときに、当該第1の記録信号S1の所定の一部でなる第3の記録信号S3に基づいてピットが形成されるデイスク基板51の凹凸面51Aの各部位にそれぞれ対向させて、それぞれ対応するピットと同じ開口寸法で複数の貫通孔52Aが穿設されている。

【0027】これは、通常、光デイスクプレイヤが光デイスクから記録信号を読み出す際、当該光デイスクに光ビームを照射し、その反射戻り光の光量が少ない部分をピットと認識することを利用したものであり、この光デイスク50では、このように反射膜層52のピット相当部に貫通孔52Aを設けることによつて反射戻り光の光量を反射膜層52の他の部分よりも少なくさせ、かくし50

て光デイスクプレイヤが各貫通孔52Aをピツトと認識して当該貫通孔52Aのかたちで反射膜層52に記録された第3の記録信号S3を読み出し得るようになされている。

【0028】ここで実際上この光デイスク50は、図6に示す光デイスク製造手順RT2に従つて製造することができる。すなわちまずステツプSP10からステツプSP15までの各工程をそれぞれ第1実施例のステツプSP0~SP5と同様にして行うことにより、図7(A)に示すような第2の記録信号S2が記録されたデイスク基板51を形成し、当該デイスク基板51の凹凸面51A上に図7(B)のように反射膜層52を積層形

【0029】続いてこのデイスク基板51の凹凸面51Aに対し、反射膜層52側からグループに沿つて光ビームを走査させることにより信号が欠落した領域(すなわち第2の記録信号S2に代えて第1の記録信号S1を記録したときに、第3の記録信号S3が記録される領域)を検出する。

【0030】次いで検出したデイスク基板51の凹凸面51Aの信号欠領域分と対向する反射膜層52に対し、第3の記録信号S3に基づいてピットが形成されるであろうデイスク基板51の凹凸面51Aの各部位とそれぞれ対向する位置に高エネルギーのCO.ガスレーザやUVレーザ等を照射することにより、図7(C)のように正規のピットに相当する開口寸法で、反射膜層52に第3の記録信号S3を追加記録するようにして貫通孔52Aを形成する(ステツプSP16)。

【0031】さらに図7(D)に示すように、この反射膜層52上にスピンコート法等を用いて光硬化性樹脂材等からなる保護膜層53を形成し(ステツプSP17)、この後この保護膜層53の表面上にラベル等を印刷する(ステツプSP18)。これにより第1の記録信号S1を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号S2が凹凸パターンとしてデイスク基板51の凹凸面51Aに記録され、かつ第1の記録信号S1の所定の一部でなる第3の記録信号S3が貫通孔52Aとして反射膜層52に記録されてなる光デイスク50を得ることができる(ステツプSP19)。

【0032】以上の構成において、この光デイスク50では、上述のように第1の記録信号S1を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信号S2が凹凸パターンとしてデイスク基板51の凹凸面51Aに記録され、かつ第1の記録信号S1の所定の一部でなる第3の記録信号S3が貫通孔52Aとして反射膜層52に記録されている。

【0033】従つて例えば光デイスク50から反射膜層52及び保護膜層53を剥離し、かくして得られたデイスク基板51に基づいて光デイスクが違法複製された場合においても当該複製された光デイスクだけでは第1の

記録信号 S 1 の全部又は一部を得ることができず、光デ イスクの違法複製を効果的かつ確実に防御することがで きる。なおこの第2実施例は、光デイスク50を既存の プレイヤで再生することができるため、CD等に適用し て好適である。

【0034】以上の構成によれば、第1の記録信号S1 を所定の一部がブランク状態となるように変調してなる 第2の記録信号S2が凹凸パターンとしてデイスク基板 51の凹凸面51Aに記録され、かつ第1の記録信号S 1の所定の一部でなる第3の記録信号53が貫通孔52 Aとして反射膜層52に記録するようにしたことによ り、デイスク基板51に基づいてだけでは第1の記録信 号S1の全部を得られないようにすることができ、かく て違法複製を効率良くかつ効果的に防御し得る光デイス ク及びその製造方法を実現できる。

【0035】(3)他の実施例

なお上述の第1実施例においては、光デイスク20に記 録されない第3の記録信号S3をフロツピイデイスク2 2に記録してユーザ21に供給するようにした場合につ いて述べたが、本発明はこれに限らず、第3の記録信号 20 号の全部を得ることができないようにすることができ、 S3をフロツピイデイスク22以外の記録媒体や、電話 回線の信号伝送路等この他種々の情報供給手段を用いて ユーザ21に供給するようにしても良い。

【0036】また上述の第2実施例においては、反射膜 層52に貫通孔52Aを形成する貫通孔形成手段として 高エネルギーのCO、ガスレーザやUVレーザを適用す るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限 らず、例えばニードル (針) 等を用いて形成するように しても良く、反射膜層52に貫通孔52Aを形成する貫 通孔形成手段としては、この他種々の手段を適用でき る。

【0037】さらに上述の第1及び第2実施例において は、第1の記録信号S1の所定の一部としてTOCを第 1の記録信号S1から欠落させるようにした場合につい て述べたが、本発明はこれに限らず、TOC以外の部分 を第1の記録信号S1から欠落させて第2の記録信号S 2を形成するようにしても良い。

[0038]

【発明の効果】上述のように第1の発明によれば、光デ イスクに、第1の記録信号を所定の一部がブランク状態 40 となるように変調してなる第2の記録信号に基づいて一 面に凹凸パターンが形成された、光透過性物質からなる デイスク基板と、デイスク基板の上記一面上に積層形成 された、高反射物質からなる反射膜層と、反射膜層上に 積層形成された所定材料からなる保護膜層とを設けるよ うにしたことにより、デイスク基板の複製だけでは第1 の記録信号の全部を得ることができないようにすること ができ、かくして違法複製を効率良くかつ効果的に防御

し得るデイスク状記録媒体及びその製造方法を実現でき

【0039】また第2の発明によれば、デイスク状記録 媒体の製造方法において、第1の記録信号を所定の一部 がブランク状態となるように変調してなる第2の記録信 号に基づいて一面に凹凸パターンが形成されたデイスク 基板を形成する第1の工程と、デイスク基板の上記一面 上に高反射物質からなる反射膜層を形成する第2の工程 とを設けるようにしたことにより、デイスク基板の複製 10 だけでは第1の記録信号の全部を得ることができないよ うにすることができ、かくして違法複製を効率良くかつ 効果的に防御し得るデイスク状記録媒体及びその製造方 法を実現できる。

【0040】さらに第3の発明によれば、第1の記録信 号を所定の一部がブランク状態となるように変調してな る第2の記録信号が記録された光デイスクを作製してユ ーザに供給すると共に、第1の記録信号の所定の一部を 所定の情報供給手段を介してユーザに供給するようにし たことにより、光デイスクの複製だけでは第1の記録信 かくして違法複製を効率良くかつ効果的に防御し得る情 報供給方法を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例による情報供給方法のようすを示す 概念図である。

【図2】第1実施例による光デイスク製造手順を示すフ ローチヤートである。

【図3】第1実施例による光デイスク製造手順の説明に 供する断面図である。

【図4】第1実施例による光デイスク製造手順の説明に 30 供する断面図である。

【図5】第2実施例による光デイスクの構成を示す断面

【図6】第2実施例による光デイスク製造手順を示すフ ローチヤートである。

【図7】第2実施例による光デイスク製造手順の説明に 供する断面図である。

【図8】従来の光デイスク製造手順の説明に供する断面 図である。

【図9】従来の光デイスク製造手順の説明に供する断面 図である。

【符号の説明】

20、50……光デイスク、21……ユーザ、22…… フロツピイデイスク、41、51……デイスク基板、4 1A、51A……凹凸面、42、52……反射膜層、4 3、53……保護膜層、52A……貫通孔、S1……第 1の記録信号、S 2 ……第 2の記録信号、S 3 ……第 3 の記録信号、RT1、RT2……光デイスク製造手順。

【図5】

図5 第2実施例による光デイスクの構成

51A

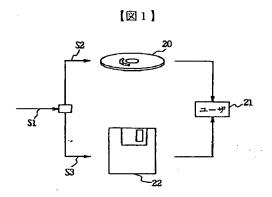


図1 第1実施例による情報供給方法

【図2】

レジスト暦形成

反射膜層形成

保護膜層形成

ラベル印刷

図2 第1実施例による光デイスク製造手順

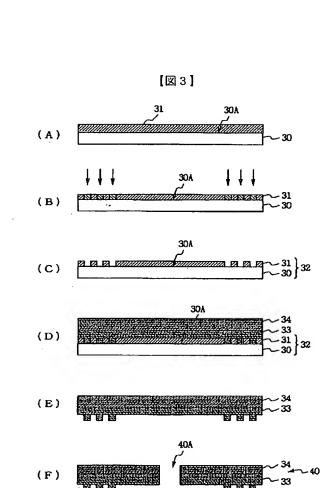


図3 第1実施例による光デイスク製造工程(1)

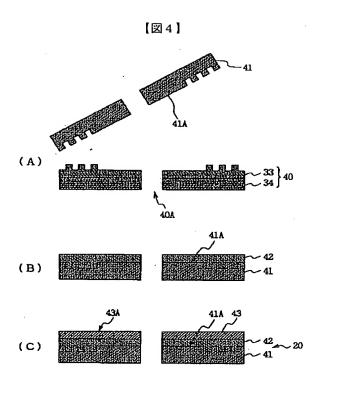


図4 第1実施例による光デイスク製造工程(2)

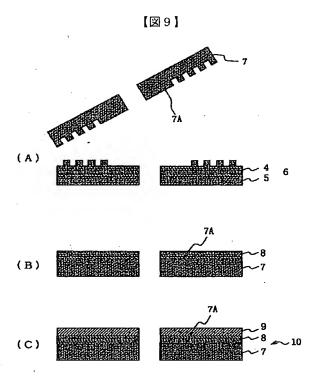


図6 第2実施例による光デイスク製造手順

図9 従来の光デイスク製造工程(2)

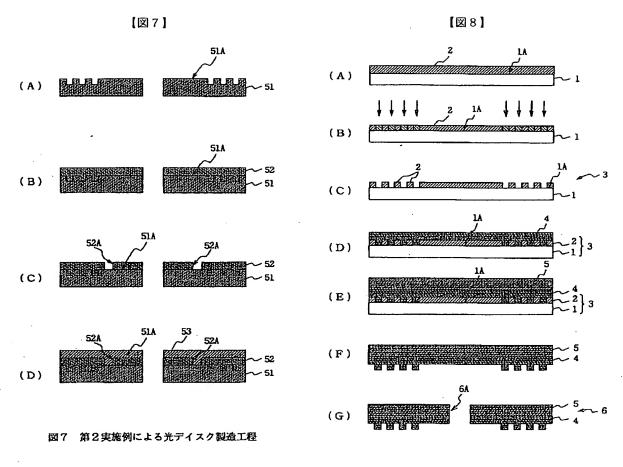


図8 従来の光デイスクの製造工程(1)